بهبود عملکرد ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی در حضور ناهمپوشانی

علی نادری^{۱،*} و مریم قدر تی^۲

 چکیدہ	اطلاعات مقاله
	دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
یکی از موارد مهم در فرآیند ساخت افزارهها در مقیاس نانومتر، ناهمپوشانی بین ناحیه	پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
گیت و نواحی درین– سورس است. در این مقاله برای اولین بار اثر ناهمپوشانی بین ناحیه	<u>. </u>
گیت و نواحی درین- سورس برای ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی بررسی شده	واژگان کلیدی:
است. برای مطالعه و شبیهسازی مشخصات الکتریکی افزاره از حل خودسازگار معادلههای	جريان نشتي،
پواسون- شرودینگر و روش تابع گرین غیر تعادلی استفاده شده است. عملکرد افزاره	حاصلضرب توان در تأخير،
برحسب جریان حالت روشن، جریان حالت خاموش، نسبت جریان، نوسان زیر آستانه، زمان	ترانزيسـتور اثرميدانى نانولوله
تأخیر و حاصلضرب توان در تأخیر ارزیابی شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که	كربنى تونلى،
اثر ناهمپوشانی بعضی مشخصههای افزاره را بهبود میبخشد و روی برخی مشخصهها	روش تابع گرين غيرتعادلي.
همانند جریان اشباع اثر نامطلوب دارد. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که ناهمپوشانی	
جریان حالت خاموش را به طور قابل توجهی کاهش میدهد و در نتیجه موجب کاهش	
تونلزنی نوار به نوار و رفتار آمبایپلار افزاره میگردد. همچنین وجود ناهمپوشانی باعث	
بهبود پارامتر حاصلضرب توان در تأخیر در مقایسه با ساختار پایه میشود. اگرچه	
ناهمپوشانی عمدتاً به صورت ناخواسته در فرآیند ساخت ایجاد میشود اما با ایجاد تعمدی	
آن نیز میتوان از مزایای مذکور استفاده نمود. لذا سازنده میتواند با ایجاد ناهمپوشانی و	
انتخاب بهینه طول آن، عملکرد افزاره را در برخی پارامترهای مهم به طور قابل ملاحظهای	
بهبود دهد.	

۱–مقدمه

نانولولههای کربنی به علت خواص الکتریکی منحصر به فرد، برای کاربردهای نانوالکترونیک بسیار جذاب می باشند [۱ و ۲]. یکی از گزینهها، استفاده از نانولولههای کربنی به عنوان کانال در افزارههای اثر میدان می باشد. نتایج مطلوب به دست آمده از ساخت و شبیه سازی این افزارهها باعث طراحی افزارههای اثر میدان نانولوله کربنی به عنوان یکی از گزینههای محتمل برای تکنولوژیهای آتی ساخت مدارهای الکترونیکی شده است [۳–۵]. یکی از افزارههایی که اخیراً مطرح شده ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی

تونلی (T-CNTFET) میباشد. در این ساختارها جریان حالت روشن و جریان حالت خاموش هر دو از طریق تونل زنی نوار به نوار برقرار می گردد [۶–۸]. یکی از عواملی که باعث افزایش توان مصرفی در افزارههای مبتنی بر سیلیکون میشود نشتی زیرآستانه است. ساختارهای تونلی به دلیل مهشود نشتی زیرآستانه است. ساختارهای تونلی به دلیل ماهیت جریان آنها، دارای نوسان زیرآستانه مناسبی هستند. محدوده نظری نوسان زیرآستانه برای MOS-CNTFET ها محدوده نظری نوسان زیرآستانه است ولی T-CNTFET ها نوسان زیرآستانه کمتر از ۶۰ mV/dec دارند [۹–۱۱]. بسیاری از پژوهشگران و محققان به دنبال ارائه ساختارهایی

^{*} پست الكترونيك نويسنده مسئول: a.naderi@kut.ac.ir

۱. دانشیار، دانشکده انرژی– دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۲. دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

ترانزیستورها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه و شبیهسازی مشخصات افزاره از حل خودسازگار معادلههای پواسون- شرودینگر و روش تابع گرین غیرتعادلی (NEGF)، استفاده شده است. در بخش ۲ تشریح ساختار ترانزیستور، شرایط و روش شبیهسازی بیان می گردد. در بخش ۳ نتایج شبیهسازی ارائه می شود و در بخش ۴ نتیجه گیری مطرح خواهد شد.

۲- ساختار افزاره و روش شبیهسازی

نمای دوبعدی ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی ساختار متداول، ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت و ساختار ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی نواحی درین- سورس در شکل (۱) نشان داده شده است. اثر ناهمپوشانی به دو صورت بررسی شده است، حالت اول شکل (۱- ب) که در آن طول فلز گیت نسبت به حالت ايدهآل آن يعنى شكل (١- الف) كمتر است و اين باعث عدم همپوشانی در ساختار افزاره شده است. حالت دوم شکل (۱-ج) است که در آن فلز گیت دارای طول ایده آل می باشد اما ناخالصی درین و سورس در نواحی با طول کمتر از حالت ايدهآل شكل (۱- الف) توزيع شدهاند. تفاوت شكلهاي (۱-ب) و (ج) در نحوه ایجاد ناهمپوشانی، طول مؤثر فلز گیت و طول نواحی دارای ناخالصی در درین و سورس میباشد. به صورت خلاصه، مهمترین تفاوت شکلهای (۱-ب) و (ج) در طول مؤثر گیت است که پارامتری تعیین کننده میباشد. ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی مورد بررسی، یک نانولوله کربنی زیگزاگ (۱۳،۰) با گیت استوانهای هم محور است که در آن طول کانال ۲۰ نانومتر و طول درین-سورس ۳۰ نانومتر فرض شده است.

ناخالصی وارد شده در سمت سورس از نوع P و ناخالصی وارد شده در سمت درین از نوع n میباشد که مقدار چگالی ناخالصی در آنها ^۱ nm^{-۱} فرض شده است. جنس عایق دیالکتریک HFO₂ با ثابت دیالکتریک ۱۶ و ضخامت ۲ نانومتر انتخاب شده است. طول ناهمپوشانی برای این بخش از شبیهسازیها ۵ نانومتر در نظر گرفته شده است. در این مقاله برای شبیهسازی افزاره از مدلسازی عددی معادله شرودینگر با استفاده از روال تابع گرین غیر تعادلی به صورت خودسازگار با معادله پواسون استفاده شده است. روش NEGF در چهار مرحله کلی انجام میگردد: مرحله اول، مشخص کردن مجموعه پایه مناسب و ماتریس هستند که بتوانند نوسان زیرآستانه و میزان نسبت جریان را در ترانزیستورهای تونلی بهبود بیشتری دهند. در راستای بهبود عملكرد T-CNTFET روشهاى مختلفى ييشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است [۲، ۶، ۸ و ۱۱]. استفاده از این روشها علاوه بر این که موجب کاهش نوسان زیرآستانه و جریان حالت خاموش می گردد، باعث افزایش جریان حالت روشن نیز می شود [۱۱-۱۹]. پژوه شگران در برخی از مقالات اثرات غیر ایده آل همپوشانی و ناهمپوشانی را بر روی تکنولوژیهای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند. از آن جمله بررسی اثر دو هاله نامتقارن و ناهمپوشانی بر روی ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی سد شاتکی است که در آنها از ماده سیلیسیم به عنوان کانال استفاده شده است [۱۵]. فیزیک الکترونیک و تئوری انتقال در کانالهای سیلیسیمی متفاوت با کانالهای کربنی است. نتایج كانالهاى سيليسيمي قابل استفاده مستقيم براى كانالهاى نانولوله کربنی نمی باشند و نتایج متفاوتی دارند. در [۱۶] اثر همپوشانی بر مشخصات فرکانس بالای ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی بررسی شده است و در [۴] نیز اثر همپوشانی بر روی عملکرد ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی غیر تونلی ارزیابی شده است. آنچه در مقاله حاضر ارائه خواهد شد بررسی اثر ناهمپوشانی بین ناحیه گیت و نواحی درین- سورس در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی است. ناهمپوشانی بین گیت و نواحی درین-سورس ممكن است به دو دليل رخ بدهد، عدم دقت كافي در پروفایل دوپینگ درین- سورس به طوری که بخشی از نواحی درین- سورس بدون ناخالصی باقی بماند و عامل دیگر ناهمپوشانی، نبود دقت کافی در پیادهسازی طول فلز گیت است که ممکن است کوتاهتر از طول مورد نظر باشد كه اين امر باعث كوتاه شدن طول مؤثر كانال مي گردد. البته سازنده در صورت در اختیار داشتن ابزارهای ساخت مناسب می تواند ناهمپوشانی را به صورت خواسته نیز ایجاد نماید. دراین مقاله اثرات ناهمپوشانی روی عملکرد افزاره در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی برای ساختاری که اثر ناهمپوشانی باعث کاهش طول فلز گیت می شود و دوم برای ساختاری که اثر ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی نواحی درین- سورس است. هر دو این ساختارها با ترانزیستور اثرمیدانی نانولوله کربنی تونلی پایه مقایسه شده و مشخصههای الکتریکی آنها استخراج شده است و تأثیر اندازه طول ناهمپوشانی بر رفتار این نوع

Gate tox 1 HFO2 **CNT-Diameter** p-CNT I-CNT n-CNT tox 1 HFO2 Ls LD (الف) LG Lunderlapped LG-underlapped Gate tox theo2 CNT-Diameter p-CNT n-CNT I-CNT tox 1 HFO2 Gate LD \mathbf{Ls} (ب) Lunderlapped Gate tox thro2

مرحله به دست میآید [۳ و ۴].

هامیلتونی برای یک کانال ایزوله شده است. پتانسیل خودسازگار که قسمتی از ماتریس هامیلتونی است در این

(ج) شکل ۱- نمای سطح مقطع دوبعدی الف) ساختار ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونلی متداول ب) ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت ج) ساختار ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین- سورس

I-CNT

Gate

Le

مرحله دوم، محاسبه ماتریسهای خود- انرژی است که چگونگی تزویج کانال بالستیک به اتصالهای سورس/ درین را توضيح مي دهد. مرحله سوم محاسبه تابع گرين است كه پس از مشخص کردن ماتریس هامیلتونی و خود انرژیها حاصل می شود [۳-۵].

CNT-Diameter

n-CNT

LD

$$G_{q}(E) = [(E + i\eta^{+})I - H - \sum S - \sum D]^{-1} \qquad (1)$$

I که در آن E انرژی، η^+ یک مقدار مثبت بینهایت کوچک، Eماتریس واحد است. مرحله چهارم یافتن کمیتهای فیزیکی مانند چگالی بار و جریان با استفاده از تابع گرین به دست آمده می باشد [۵ و ۶]. در روش NEGF از روش تکرار خودسازگار استفاده می شود در این الگوریتم دو معادله به

روش تكرار حل می گردند. معادله اول معادله انتقال است که در آن ماتریس چگالی بار الکترونها ho به دست میآید. سپس در معادله پواسون با معلوم بودن چگالی بار ho ، مقدار ${\rm U}$ جدید پتانسیل ${\rm U}$ به دست میآید و این مقدار جدید مجدداً به معادله انتقال اعمال شده و مقادیر جدید چگالی به دست میآید. با حل تکراری معادلههای شرودینگر و پواسون مقادیر پتانسیل و چگالی همگرا خواهند شد. پس از همگرایی، جریان از رابطه (۲) محاسبه می شود [۳–۵]: I =(٢) $\frac{2q}{h}\int T(E)[F(E-E_{FS})-F(E-E_{FD})]dE$

p-CNT

Ls

tox



 E_{FS} که p بار الکترون، h ثابت پلانک، T(E) ضریب انتقال و E_{FS} و E_{FD} تراز فرمی سورس و درین هستند که با توجه به جزییات ذکر شده در [۱۴] درحالتی که الکترود درین، سورس زمین است سطح فرمی صفر میباشد و با اعمال ولتاژ به میزان ولتاژ اعمال شده اختلاف بین سطوح فرمی درین و سورس ایجاد خواهد شد [۱۴]. ضریب انتقال از رابطه (۳) قابل محاسبه است [۴ و ۵]:

$$T(E) = trace(\Gamma_s G \Gamma_D G^+) \tag{(7)}$$

که در آن G تابع گرین است و (Γs(D گسترش سطح انرژی به علت اتصالهای سورس و درین است که توسط رابطه (۴) محاسبه شده است [۴ و ۵].

$$\Gamma_{S(D)} = i \left(\sum_{S(D)} -\sum_{S(D)}^{+} \right)$$
(*)

لازم به ذکر است که برای گسستهسازی و مدلسازی عددی ساختار ترانزیستور در دو بعد، اندازه مشها در جهت Z برابر ۰/۲۵ نانومتر و در جهت R برابر ۰/۱ نانومتر در نظر گرفته شده است و در هر دو جهت مذکور مشبندی به صورت یکنواخت انتخاب شده است.

۳- نتایج شبیهسازی

۲-۱-۳ ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت

در این بخش ابتدا مشخصات نمودار ID-VGS را برای ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در شکل (۲) مورد بررسی قرار دادهایم. در این شکل نتایج شبیهسازی با ساختار متداول مقایسه شده است.



شکل ۲- مشخصه انتقال در مقیاس لگاریتمی برای ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در V_{DS}= ۰/۲۰۰/۴ V.

با توجه به شکل (۲) ملاحظه می شود که اثر ناهمپوشانی باعث کاهش جریان نشتی نسبت به ساختار متداول می-شود. این کاهش در جریان نشتی به دلیل کاهش احتمال تونلزنی نوار به نوار ایجاد شده است. علاوه بر این دیده می شود که جریان در ولتاژهای گیت- سورس منفی نیز روند کاهشی دارد. کاهش در جریان درین در بایاسهای منفی به معنای کاهش و یا به عبارتی بهبود رفتار آمبای پلار افزاره می باشد. نمودار ID-V_{DS} به ازای ولتاژهای مختلف افزاره می باشد. نمودار (۳) نمایش داده شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی، اثر ناهمپوشانی باعث کاهش جریان اشباع می شود این در حالی است که جریان اشباع برای ساختار متداول مقدار بیشتری دارد.



شکل ۳- نمودار ID-V_{DS} برای ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در V_{GS}= ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶ V.

ناهمپوشانی دچار پهن شدگی شده اما مجموعاً از شدت آن کاسته شده است. مجموع این طیف جریان نشتی را تشکیل میدهد. میزان جریان طیفی عبوری با شدت رنگ سفید متناسب است. مشخص است که در اطراف انرژی منفی ۵/۰ الکترون ولت که کمترین فاصله افقی بین نواری ایجاد میشود، شدت رنگ سفید در ساختار پایه بیش از ساختار دارای ناهمیوشانی است.

برای بررسی بیشتر ساختار مورد نظر، اثر ناهمپوشانی را به ازای طولهای مختلف ۲، ۴، ۵ و ۶ نانومتر مورد بررسی قرار دادهایم و نسبت جریان حالت روشن به خاموش را برای ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت ارزیابی نمودهایم.









 V_{DS} = ۰/۴ V در این بررسی جریان حالت خاموش در بایاس V_{DS} ۰/۴ V و جریان حالت روشن در بایاس V_{GS} ۰ V V_{GS} ۰ ۷ و V_{GS} در نظر گرفته شده است. با توجه به شکل Δ دیده میشود که افزایش طول ناهمپوشانی منجر به افزایش نسبت جریان می گردد ولی هرچه طول ناهمپوشانی بیشتر می گردد.



شکل ۵- نمودار نسبت جریان برحسب جریان حالت روشن برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در ۷ VDs= ۰/۴ V.

برای بررسی رفتار حالت روشن و خاموش افزاره زمان تاخیر (۲) و حاصل ضرب توان در تاخیر (PDP)، که به ترتیب با رابطههای (۵) و (۶) تعریف می شوند مورد ارزیابی قرار \mathcal{R}_{0} گرفته و با ساختار متداول مقایسه شده است [۴–۶]. $\tau = (Q_{ON} - Q_{OFF}) / I_{ON}$ (۵)

 $PDP = (Q_{ON} - Q_{OFF})V_{DD}$ (7)

در این روابط، $Q_{OFF} = Q_{OFF}$ کل بار در داخل ترانزیستور در حالت روشن در بایاس $V_{PS} = ... V_{PS} = ... V_{PS} = ... V_{QS}$ و $V_{GS} = ... V_{DS} = ... V_{DS} = ... V_{QS}$ و $V_{PS} = ... V_{QS}$ است. در شکل $V_{DS} = ... V_{PS}$ رالف) نمودار تأخیر برحسب نسبت جریان نشان داده شده است. ملاحظه می شود که با افزایش طول ناهمپوشانی از ۲ تا ۶ نانومتر زمان تأخیر افزایش یافته است. در مقایسه با ساختار متداول زمان تأخیر در طول ناهمپوشانی ۲ نانومتر مقدار کمتری دارد ولی در طول های ۲، ۵ و ۶ نانومتر این مقدار افزایش می یابد و این امر به دلیل کاهش جریان حالت روشن می باشد. لذا چون زمان تأخیر با جریان حالت روشن رابطه عکس دارد بنابراین با کاهش جریان اشباع در طول های بیشتر ناهمپوشانی، زمان تأخیر



شکل (۶-ب) نمودار حاصل ضرب توان در تأخیر را برحسب

نسبت جریان نشان میدهد. دیده می شود که افزایش طول ناهمپوشانی باعث کاهش قابل توجه PDP می شود. در مقایسه با ساختار متداول در طول ناهمپوشانی ۵ نانومتر حاصل ضرب توان در تأخیر مقدار کمتری دارد، بنابراین برای کاربردهای با توان مصرفی پایین گزینه مناسبی است. نوسان زیرآستانه پارامتر مهم دیگری است که هرچه مقدار آن کمتر باشد نشان دهنده مزیت ترانزیستور برای استفاده در کاربردهای با توان مصرفی پایین در ناحیه زیرآستانه است. نوسان زیرآستانه بر حسب میلی ولت بر ded از فرمول زیر تعیین می شود [۴ و ۵]:

 $SS = 10^3 \frac{V_{GS2} - V_{GS1}}{\log(I_{DS2}) - \log(I_{DS1})}$ (Y)



شکل ۷- نمودار نوسان زیرآستانه برحسب طولهای مختلف کانال، از ساختارهای متداول و ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در V_{DS}=۰/۴ V.

نمودار نوسان زیرآستانه برحسب طولهای مختلف کانال برای ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در ولتاژ درین- سورس ۲/۴ ولت در شکل (۷) نشان داده شده است. با توجه به شکل (۷) در طولهای کانال کوچکتر اثر ناهمپوشانی باعث افزایش نوسان زیرآستانه می گردد که این به معنی کم بودن شیب زیرآستانه و بالا بودن جریان نشتی می باشد. در حالی که در طولهای کانال بزرگتر نوسان زیرآستانه بهبود پیدا کرده است.

۳-۲-ساختار ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس

مشخصات نمودار ID-VGs برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی سورس و درین

در شکل (۸) مورد ارزیابی واقع شده است. دیده می شود که اثر ناهمپوشانی باعث کاهش جریان نشتی نسبت به ساختار متداول می گردد بنابراین کاهش جریان در ولتاژهای گیت-سورس منفی باعث بهبود رفتار آمبای پلار افزاره و تونلزنی نوار به نوار می شود.



شکل ۸- مشخصه ID-V_{GS} برای ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس در V_{DS}= ۰/۲، ۰/۴ V.

نمودار ID-V_{DS} به ازای ولتاژهای مختلف گیت- سورس در شکل (۹) نمایش داده شده است. با توجه به نمودار کاهش جریان اشباع در مقایسه با ساختار متداول کاملاً مشهود است.



شکل ۹- نمودار ID-VDs برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس در VGS= ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶ V شکل (۱۰) دیاگرام نوار انرژی را برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس نشان میدهد.





شکل ۱۰ - مقایسه دیاگرام نوار انرژی ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس الف) در بایاس V_{DS}= ۰/۴ ۷ و V_{GS}= ۰/۴ Vب) در بایاس V_{DS}= ۰/۴ V



شکل ۱۱- نمودار نسبت جریان برحسب جریان حالت روشن برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس در ۷ ۰/۴ V_DS=-۷.

با توجه به شکل (۱۰) دیده می شود که اثر ناهمپوشانی باعث گستردهتر شدن سد تونلزنی در محل اتصال درین-کانال و سورس- کانال می شود در نتیجه این امر کاهش جریان نشتی را به همراه دارد. نمودار نسبت جریان برحسب جریان حالت روشن برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس در طولهای مختلف ناهمپوشانی در شکل (۱۱) نشان داده شده است.





مشاهده میشود که افزایش طول ناهمپوشانی از ۲ تا ۶ نانومتر منجر به افزایش نسبت جریان در مقایسه با ساختار متداول مي گردد.

در شکل (۱۲- الف) و (ب) نمودار تأخیر و حاصل ضرب توان در تأخیر برحسب نسبت جریان نشان داده شده است. با

توجه به نتایج حاصله با افزایش طول ناهمپوشانی زمان تأخير افزايش مييابد و اين امر به دليل كاهش جريان حالت روشن است همچنین دیده می شود که افزایش طول ناهمپوشانی باعث کاهش قابل توجه PDP در مقایسه با ساختار متداول می شود.

نمودار نوسان زيرآستانه برحسب طولهاى مختلف كانال برای ساختار متداول و ساختار ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخاصی درین- سورس در شکل (۱۳) نشان داده شده است. مشاهده می گردد که با افزایش طول کانال و در طول ناهمپوشانی ۵ نانومتر نوسان زیرآستانه روند کاهشی دارد. ولی در مقایسه با ساختار متداول نوسان زیر آستانه در طول های کمتر کانال بهبود یافته و با افزایش طول کانال نوسان زیر آستانه نسبت به ساختار متداول بیشتر شده است.



شکل ۱۳- نمودار نوسان زیر آستانه برحسب طول های مختلف کانال، برای ساختارهای متداول و ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس در VDS=•/۴ V.

۴- نتیجهگیری

در این مقاله به بررسی اثرات ناهمپوشانی بر روی عملکرد ترانزیستور اثر میدان نانولوله کربنی تونلی با دو رویکرد اثر ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت و اثر ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل شده از مقایسه هر دو مورد مذکور، اثر ناهمپوشانی باعث کاهش جریان اشباع افزاره می شود و به طور قابل توجهی جریان نشتی را کاهش میدهد. دیده می شود که در ولتاژهای گیت- سورس منفی نیز جریان روند کاهشی دارد که باعث بهبود رفتار آمبای پلار افزاره می شود. علاوه بر این ناهمپوشانی با کاهش طول فلز گیت در طولهای کانال کوچکتر باعث افزایش نوسان زیرآستانه می گردد در حالی که در طولهای کانال بزرگتر نوسان ۶ نانومتر منجر به افزایش نسبت جریان در مقایسه با ساختار متداول می گردد. هرچه طول ناهمپوشانی بیشتر شود کاهش جریان اشباع قابل ملاحظهتر می گردد. نتایج بررسی روی ساختارهای دارای ناهمپوشانی نشان میدهد که با کاهش حاصل ضرب توان در تأخیر در مقایسه با ساختار متداول، این ساختارها برای کاربردهای با توان مصرفی پایین گزینه مناسب تری محسوب می شوند. زیرآستانه بهبود پیدا کرده است. در اثر ناهمپوشانی ناشی از کامل نبودن ناخالصی درین و سورس دیده شد که با افزایش طول کانال و در طول ناهمپوشانی ۵ نانومتر نوسان زیرآستانه روند کاهشی دارد که در مقایسه با ساختار متداول، نوسان زیرآستانه در طولهای کمتر کانال بهبود یافته و با افزایش طول کانال نسبت به ساختار متداول مقدار آن بیشتر شده است. از مقایسه نسبت جریان برای هر دو مورد مشاهده می شود که افزایش طول ناهمپوشانی از ۲ تا

مراجع

[1] S.O. Koswatta, D.E. Nikonov, and M. S. Lundstrom, "Computational study of carbon nanotube p-i-n tunnel FETs", IEEE International Electron Devices Meeting, IEDM Technical Digest, December 2005, pp. 518–521.

[2] M.J. Lee, and W.Y. Choi, "Effects of Device Geometry on Hetero-Gate-Dielectric Tunneling Field-Effect Transistors", IEEE Electron Device Letters, Vol. 33, No. 10, October 2012, pp. 1459–1461.

[3] A. Naderi, and S.A. Ahmadmiri, "Attributes in the Performance and Design Considerations of Asymmetric Drain and Source Regions in Carbon Nanotube Field Effect Transistors: Quantum Simulation Study", ECS Journal of Solid State Science and Technology, Vol. 5, No.7, May 2016, pp.M63–M68.

[4] A. Naderi, and P. Keshavarzi, "The effects of source/drain and gateoverlap on the performance of carbon nanotube field effect transistors", Superlattices and Microstructures, Vol. 52, No. 5, November 2012, pp. 962–976.

[5] A. Naderi, and M. Ghodrati, "Improving band-to-band tunneling in a tunneling carbon nanotube field effect transistor by multi-level development of impurities in the drain region", The European Physical Journal Plus, Vol. 132, December 2017.

[6] D.L. Pulfrey, and L. Chen, "Comparison of p-i-n and n-i-n carbon nanotube FETs regarding high-frequency performance", Solid-State Electron, Vol. 53, No. 9, September 2009, pp. 935–939.

[7] L. M. Peng, Z. Zhang, and S. Wang, "Carbon nanotube electronics: recent advances", Materials Today, Vol. 17, No. 9, November 2014, pp. 433–442.

[8] A.K. Sharma, R. Gupta, and A. Sharma, "Comparison of the Proposed Device With Conventional Gate All Around Tunnel Field Effect Transistor GAA-TFET", International Journal of Science, Technology and Management, Vol. 03, No. 09, September 2014, pp. 1537–2394.

[9] A. Rahman, J. Guo, and S. Datta, "Theory of Ballistic Nanotransistors", IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 50, No. 9, September 2003, pp. 1853–1864.

[10] W. Wang, X. Yang, N. Li, G. Xiao, S. Jiang, C. Xia, and Y. Wang, "Transport study of gate and channel engineering on the surrounding gate CNTFETs based on NEGF quantum theory", Journal of Computational Electronics, Vol. 13, NO. 1, March 2014, pp. 192–197.

[11] H. Wang, Sh. Chang, Y. Hu, H. He, J. He, Q. Huang, F. He, and G. Wang, "A Novel Barrier Controlled Tunnel FET", IEEE Electron Device Letters, Vol. 35, No. 7, May 2014, pp. 798–800.

[12] A. Naderi, and M. Ghodrati, "Cut Off Frequency Variation by Ambient Heating in Tunneling p-i-n CNTFETs", ECS Journal of Solid State Science and Technology, Vol. 7, No. 2, January 2018, pp. M6–M10.

[13] A. Naderi, and M. Ghodrati, "An efficient structure for T-CNTFETs with intrinsic-n-doped impurity distribution pattern in drain region", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 26, No. 5, August 2018, pp. 2335–2346.

[14] J. Guo, "Carbon nanotube electronics: Modeling, physics, and applications", Purdue University, August, 2004.

[15] A. Shaker, M. Ossaimee, A. Zekry, "Effect of asymmetrical double-pockets and gate-drain underlap on Schottky barrier tunneling FET: Ambipolar conduction vs. high frequency performance", Superlattices and Microstructures, Vol. 96, 2016, pp. 179–190.

[16] A. Shaker, M. Ossaimee, A. Zekry, M. Abouelatta, "Influence of Gate Overlap Engineering on Ambipolar and High Frequency Characteristics of Tunnel-CNTFET", Superlattices and Microstructures, Vol. 86, October 2015, pp. 518–530.

[۱۷] بهروز عبدی تهنه و علی نادری، "ساختار جدید ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی تونلزنی با دوپینگ خطی در ناحیه درین: شبیهسازی عددی کوانتومی"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۶، شماره ۵۲، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۱۰۹–۱۱۱.

[۱۸] علی اصغر اروجی، اکرم عنبر حیدری و زینب رمضانی،" ترانزیستور اثر میدان فلز- نیمه هادی با ناحیه بدون ناخالصی در طرف درین برای اصلاح چگالی حاملها و کاربردهای توان بالا"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۳، شماره ۴۳، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱۲۱-۱۲۷.

[۱۹] میثم زارعی و مهسا مهراد، " تکنیک نوین برای کاهش اثر خودگرمایی در ترانزیستورهای اثرمیدان با سورس و درین گسترده شده"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۶، شماره ۵۳، تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱۴۹–۱۵۵.